

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成24年7月12日(2012.7.12)

【公開番号】特開2012-83765(P2012-83765A)

【公開日】平成24年4月26日(2012.4.26)

【年通号数】公開・登録公報2012-017

【出願番号】特願2011-247237(P2011-247237)

【国際特許分類】

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

H 0 1 L 27/32 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/14 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/06 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

【F I】

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 6 5 Z

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/14 Z

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/08 1 0 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年5月28日(2012.5.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

発光素子と、前記発光素子に流れる電流量を制御する機能を有するF E Tと、を含む画素部を有する電子装置の作製方法であって、

シール材を用いて、前記F E Tのチャンネルが形成される単結晶半導体基板と、カバー材と、を貼り合わせ、

前記単結晶半導体基板、前記シール材、及び前記カバー材によって形成される空間内に、前記開口部から充填材を注入し、

前記充填材を硬化させることを特徴とする電子装置の作製方法。

【請求項2】

発光素子と、前記発光素子に流れる電流量を制御する機能を有するF E Tと、を含む画素部を有する電子装置の作製方法であって、

シール材を用いて、前記F E Tのチャンネルが形成される単結晶半導体基板と、カバー材と、を貼り合わせ、

前記単結晶半導体基板及び前記カバー材を切断することによって、前記開口部を前記シール材の端面に露出させ、

前記単結晶半導体基板、前記シール材、及び前記カバー材によって形成される空間内に、露出された前記開口部から充填材を注入し、

前記充填材を硬化させることを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、  
前記 F E T は、前記単結晶半導体基板に設けられた L D D 領域を有することを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一において、  
紫外線を照射することによって前記充填材を硬化させることを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一において、  
加熱することによって前記充填材を硬化させることを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、  
前記シール材は、棒状のスペーサを有することを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、  
前記シール材は、光硬化性樹脂を有することを特徴とする電子装置の作製方法。

## 【請求項 8】

発光素子と、前記発光素子に流れる電流量を制御する機能を有する F E T と、を含む画素部と、  
前記 F E T のチャンネルが形成される単結晶半導体基板上に、前記画素部を取り囲むように設けられ、且つ開口部を有するシール材と、  
前記シール材によって前記単結晶半導体基板上に固着されたカバー材と、  
前記単結晶半導体基板、前記シール材、及び前記カバー材によって形成される空間内に充填された充填材と、  
を有することを特徴とする電子装置。

## 【請求項 9】

発光素子と、前記発光素子に流れる電流量を制御する機能を有する F E T と、を含む画素部と、  
前記 F E T のチャンネルが形成される単結晶半導体基板上に、前記画素部を取り囲むように設けられ、且つ開口部を有する第 1 のシール材と、  
前記第 1 のシール材によって前記単結晶半導体基板上に固着されたカバー材と、  
前記第 1 のシール材の外側において、前記単結晶半導体基板の側面と前記カバー材の側面とを覆う第 2 のシール材と、を有し、  
前記第 2 のシール材は、前記第 1 のシール材の側面に接して設けられていることを特徴とする電子装置。

## 【請求項 10】

発光素子と、前記発光素子に流れる電流量を制御する機能を有する F E T と、を含む画素部と、  
前記 F E T のチャンネルが形成される単結晶半導体基板上に、前記画素部を取り囲むように設けられ、且つ開口部を有する第 1 のシール材と、  
前記単結晶半導体基板上に、前記第 1 のシール材を取り囲むように設けられた第 2 のシール材と、  
前記第 1 のシール材及び前記第 2 のシール材によって前記単結晶半導体基板に固着されたカバー材と、を有し、  
前記第 2 のシール材は、前記単結晶半導体基板の側面と前記カバー材の側面とを覆い、前記第 1 のシール材の側面に接して設けられていることを特徴とする電子装置。

## 【請求項 11】

請求項 9 又は請求項 10 において、  
前記第 1 のシール材は、棒状のスペーサを有することを特徴とする電子装置。

## 【請求項 1 2】

請求項 9 乃至請求項 1 1 のいずれか一において、  
前記第 1 のシール材は、乾燥剤を有することを特徴とする電子装置。

## 【請求項 1 3】

請求項 9 乃至請求項 1 2 のいずれか一において、  
前記第 1 のシール材及び前記第 2 のシール材の少なくとも一方は、熱硬化性樹脂を有することを特徴とする電子装置。

## 【請求項 1 4】

請求項 9 乃至請求項 1 2 のいずれか一において、  
前記第 1 のシール材及び前記第 2 のシール材の少なくとも一方は、光硬化性樹脂を有することを特徴とする電子装置。

## 【請求項 1 5】

請求項 9 乃至請求項 1 4 のいずれか一において、  
前記単結晶半導体基板、前記第 1 のシール材、及び前記カバー材によって形成される空間に、充填材が充填されていることを特徴とする電子装置。

## 【請求項 1 6】

請求項 9 乃至請求項 1 4 のいずれか一において、  
前記単結晶半導体基板、前記第 1 のシール材、及び前記カバー材によって形成される空間に、不活性ガスが封入されていることを特徴とする電子装置。